

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 天风证券、平安证券 |
| 会议时间 | 2024年1月25日14:00-16:00 |
| 会议地点 | 现场 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题一：请问公司的颗粒塑封料封装（GMC）是否可用于HBM（高宽带内存）的封装？公司的这项技术是否可替代国外先进技术？</p> <p>回复：公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。</p> <p>问题二：公司产品如何迎合人工智能 Aigc. Chatgpt 等行业的巨大需求？</p> <p>回复：人工智能的实现归根结底依靠的是算法及算力的提升。目前全球的AI算力主要以GPU芯片为主。公司有产品可以应用于GPU的芯片封装。</p> <p>问题三：公司在先进封装材料方面的业务进展如何？</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>回复：在先进封装领域，公司研发了应用于 QFN、BGA、FC、SiP 以及 FOWLP/FOPLP 等封装形式的封装材料，其中应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位。</p> <p>问题四：请问公司的材料等是否应用光模块生产中，先进封装等？</p> <p>回复：光模块(optical module)是光纤通信系统的核心器件之一。其涉及的封装材料及封装形式较为多样。目前公司还没有与该领域的公司有直接业务往来。</p> <p>问题五：请问公司在扇外型晶圆级封装(FOWLP)上的产品主要有哪些？</p> <p>回复：扇外型晶圆级封装（FOWLP）是以 BGA 技术为基础，基于晶圆重构技术，将芯片布置到一块人工晶圆上，然后按照标准的 WLP 工艺类似的步骤进行封装。应用于 FOWLP 产品的配方在开发过程中需要在各性能指标间进行更为复杂的平衡，产品配方的复杂性与开发难度相对较高。目前公司自主研发的颗粒状环氧塑封料（GMC）EMG-900-C 产品系列和液态塑封料（LMC）可以用于扇外型晶圆级封装。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 1 月 25 日 |